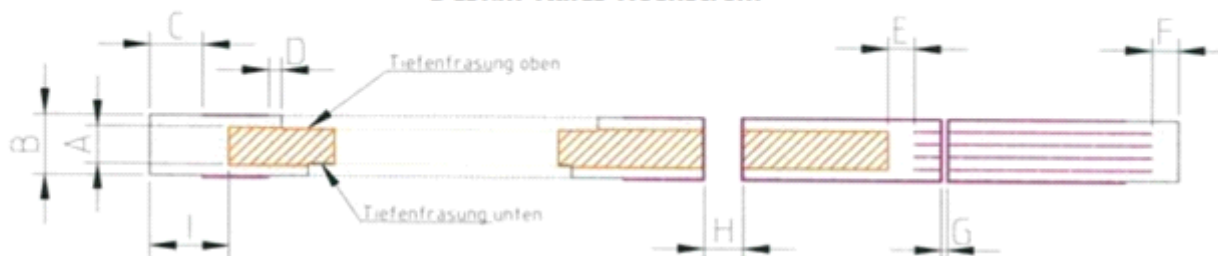


Datenblatt Herstellung Leiterplatten, Hochstrom

Layout	Strukturbreite	150 µm
	Strukturabstand	150 µm
	umlaufende Löstopplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstopplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	150 µm
	kleinster Fräsradius	500 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
	Oberfläche	chem. Zinn, chem. Ni/Au , chem. Ag
Hartgold, Bondgold		
Carbondruck		
Lötstopplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI, elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle, TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		

Design-Rules Hochstrom



A	Dicke Cu-Inlay	1,0; 1,5; 2,0 mm
B	Dicke LP	abhängig von Cu-Inlay (mind. 1,5 mm)
C	Abstand Layout zur Kante	0,5 mm
D	Abstand Layout zur Fräsung	0,5 mm
E	Abstand Layout zu Cu-Inlay	1,0 mm
F	Abstand Layout Innenlagen zur Kante	0,5 mm
G	kleinste Bohrung Layout	abhängig von Dicke LP (mind. 0,3 mm)
H	kleinste Bohrung Cu-Inlay	mind. Dicke des Cu-Inlay
I	Abstand Cu-Inlay zur Kante	kann bis an die Kante oder darüber hinaus

für Anbindungen an das Cu-Inlay sind auch "Blind Vias" möglich